

関係各位

レンゴー株式会社
広報部

TOKYO PACK 2024 ―2024 東京国際包装展― に出展します

レンゴー株式会社は、TOKYO PACK 2024 ―2024 東京国際包装展― に出展いたします。

当社ブースは「パッケージから始まる美しい環境と暮らし」をテーマに、「環境」と「暮らし」の2大ゾーンをメインに構成します。

「環境」ゾーンでは、海水や土壌での生分解性が認められ、機能が注目されているセルロース関連製品を始め、さまざまな環境対応パッケージを紹介します。「暮らし」ゾーンでは、店舗や通販で使われて暮らしを支えるソリューションを展示し、今回初出品となる省力化に寄与する新たな段ボールへの印字技術も紹介します。

少ない資源で大きな価値を生む「Less is more.」をキーワードに、包装の新たな価値を創造し続ける「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」=G P I レンゴーの最新の姿をぜひともご高覧賜りますようお願い申し上げます。



<TOKYO PACK 2024 開催概要>

会 期	2024年10月23日(水)～25日(金)	10:00～17:00
会 場	東京ビッグサイト(東京国際展示場)	東ホール
テーマ	世界が驚く包装イノベーションを! -TOKYO PACK から世界へ-	
主 催	公益社団法人日本包装技術協会(J P I)	
入 場	無料(入場にはご登録が必要です)	

(1 / 2)

<当社関連の出展／展示ブース>

- ・レンゴーブース 東1ホール 1U-13
- ・クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局（CLOMAパビリオン）に出展 東6ホール 6A-19
- ・2024 グッドパッケージング展では日本パッケージングコンテスト入賞作品 12点展示 東6ホール 6P-14

以上